

檔 號：
保存年限：

華梵大學 函

地址：223新北市石碇區華梵路1號
承辦人：童玉君
電話：02-6605-0503#3711
Email：yuchun@gm.hfu.edu.tw

受文者：臺北市立永春高級中學

發文日期：中華民國113年7月1日
發文字號：華梵推字第1130001155號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (1130001155_Attach1.pdf)

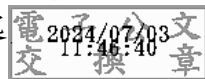
主旨：檢送本校辦理高中生暑期菁英營隊-「半導體IC設計營隊」案，請貴校合作推廣，請查照。

說明：

- 一、為提升國家半導體產業發展，並積極培育IC產業未來人才，本校辦理高中生暑期菁英營隊-「半導體IC設計營隊」培訓課程，邀請貴校學生(含應屆畢業生)參加。
- 二、上課期間為113年7月22日(星期一)至7月26日(星期五)，訓練總時數30小時，課程費用每人新臺幣9,800元。
- 三、敬邀貴校協助推廣課程，提升貴校子弟先進科技知能，隨文檢附課程簡章，敬請協助公告。

正本：全國公私立高中職學校

副本：本校推廣教育處



永春高中 1130703



NCAA1133007327